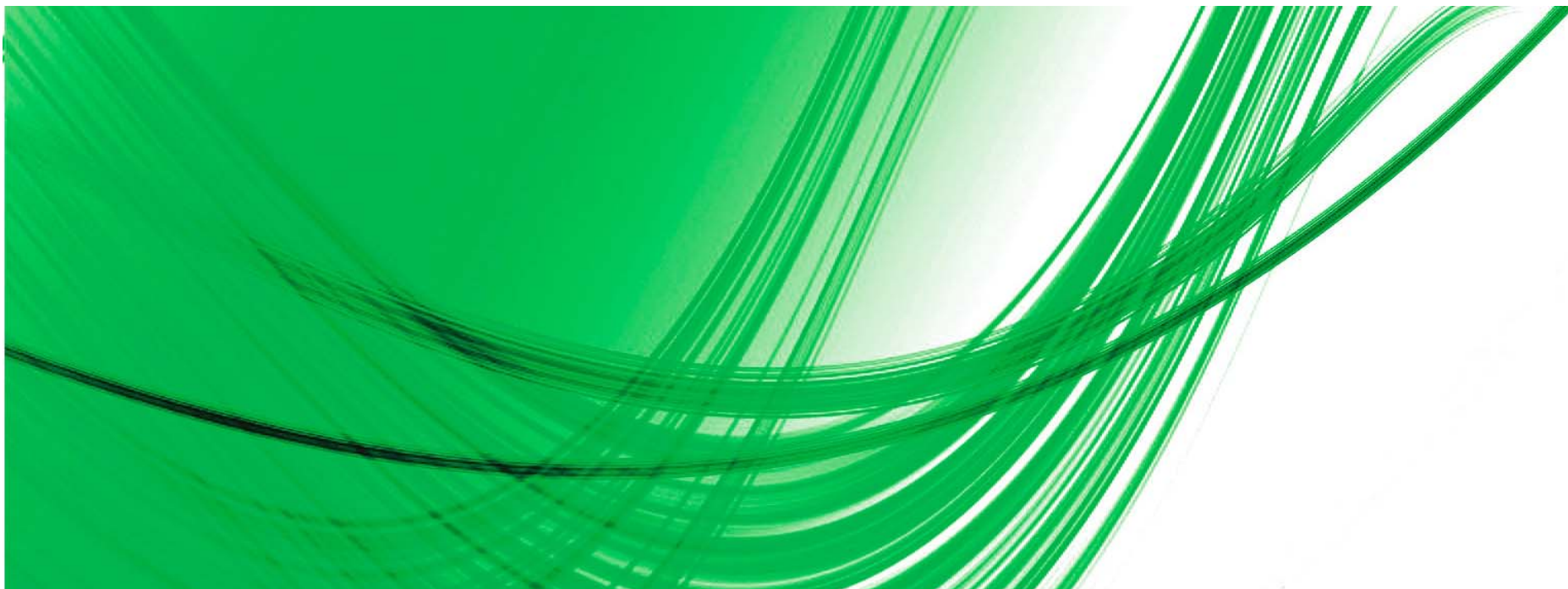




株式会社テラプローブ 決算説明資料

2013年3月期

会社説明資料



会社概要

社 名	株式会社 テラプローブ（英文名称:Tera Probe, Inc.）
本 社 所 在 地	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 雄一郎 代表取締役副社長 小平 広人
設 立	2005年8月
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリ事業 （DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、 開発受託及びWLP受託） ・ システムLSI事業 （SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品 のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託）
資 本 金	11,823百万円
連 結 子 会 社	株式会社テラミクロス（ウエハレベルパッケージ受託） TeraPower Technology Inc.（半導体ウエハテスト受託）
従 業 員 数	317名(単体)、670名(連結)

2013/3末現在

事業拠点

The map shows Japan in blue and Taiwan in light blue. Red dots on the map indicate the locations of the business bases. Lines connect these dots to detailed information boxes for each location.

海外拠点 (台湾)

TeraPower Technology Inc. (台湾新竹縣)

- 台湾のテスト拠点

国内拠点

本社・開発センター (神奈川県横浜市)

Teramikros (東京都青梅市)

- WLPの生産拠点

九州事業所 (熊本県葦北郡)

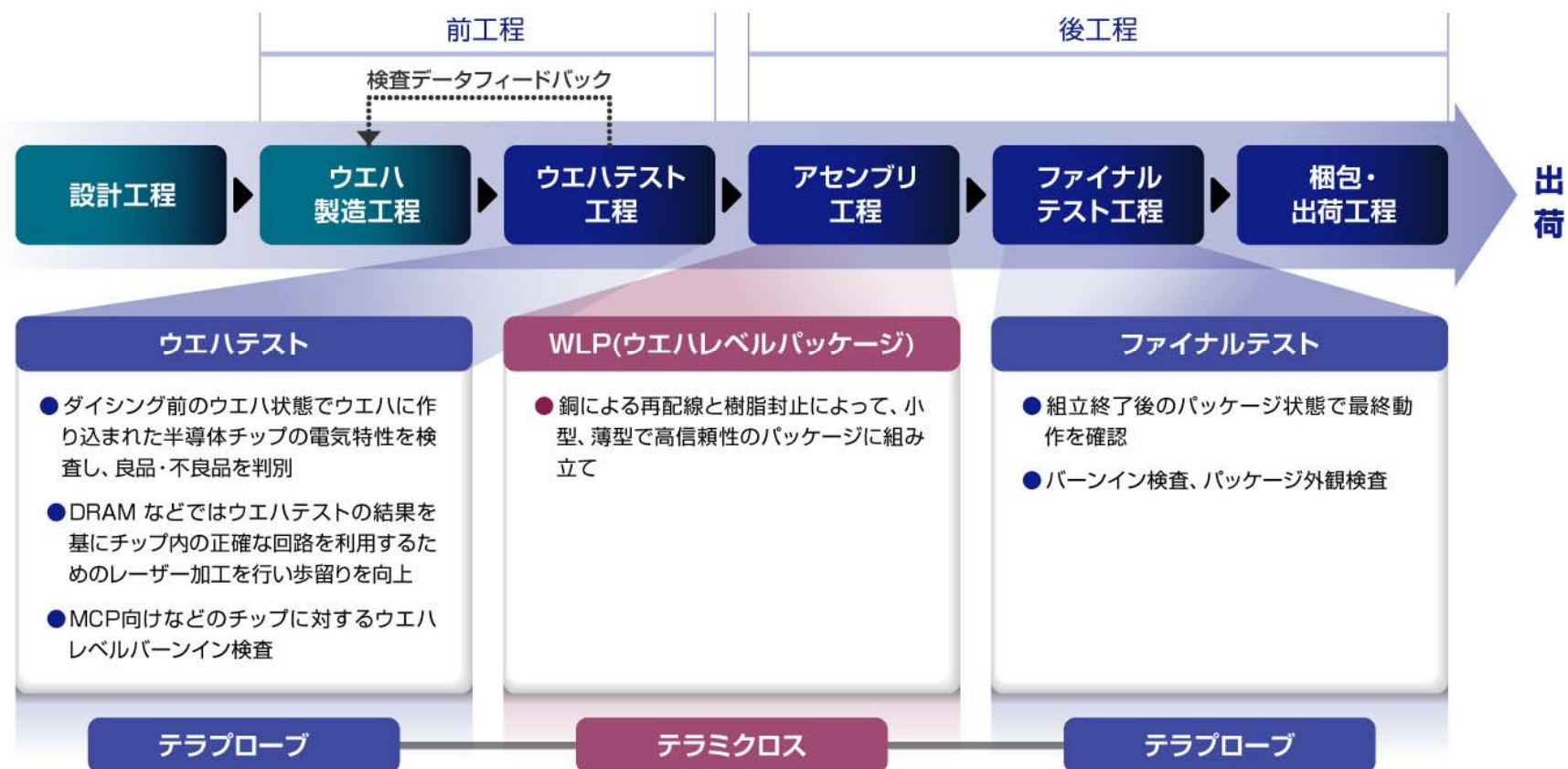
- SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

広島事業所 (広島県東広島市)

- メモリ系のテスト拠点

半導体製造工程における当社事業の役割

- テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで
- 半導体製造のバックエンド（後工程）ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウエハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

2013年3月期業績説明



今回の発表の概要

メモリ事業

- PC市場の低迷から、顧客の生産調整によりPC用DRAMの受託数量が大幅減
- スマートフォンなどの好調により、モバイル用DRAMは受託数量増

システムLSI事業

- 新規顧客獲得もあったが、テスト受託はほぼ横ばい
- WLP受託はモバイル製品向けが生産調整等により受託数量減



経費削減を行うも、受託数量減により減収減益

2012年度 通期・第4四半期 実績

(億円)

	前年同期比較			前四半期比較		
	FY2011	FY2012	YoY増減	3Q/FY2012	4Q/FY2012	QoQ増減
メモリ	197.5	152.5	-45.0	34.2	37.4	3.2
システムLSI	45.3	60.7	15.4	13.6	12.7	-0.9
その他	-0.8	-0.1	0.7	-0.0	0.1	0.1
売上高	241.9	213.1	-28.8	47.8	50.2	2.4
メモリ	49.7	18.7	-31.0	2.0	4.4	2.4
システムLSI	-10.0	-5.0	5.0	-2.0	-2.9	-0.9
その他	-12.6	-14.2	-1.6	-3.3	-3.4	-0.1
営業利益	27.1	-0.4	-27.5	-3.3	-1.8	1.5
営業利益率	11%	0%	—	-7%	-4%	—
当期純利益	-55.3	5.0	60.3	-2.3	3.6	5.9
当期純利益率	-23%	2%	—	-5%	7%	—

※3Q/FY2011よりシステムLSI事業にWLPが含まれております

2012年度実績増減分析(売上高)

2012年度実績(YoY)

<メモリ事業>

- ・モバイル向け製品は、受託数量の増加するが、PC向け製品は、数量の大幅減少により、売上高が大きく減少

<システムLSI事業>

- ・テラミクロスの業績が年間寄与したことによりWLP分が売上増加

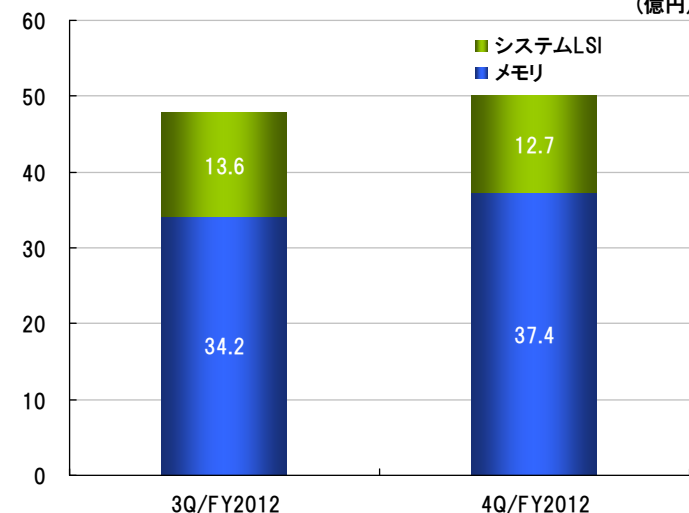
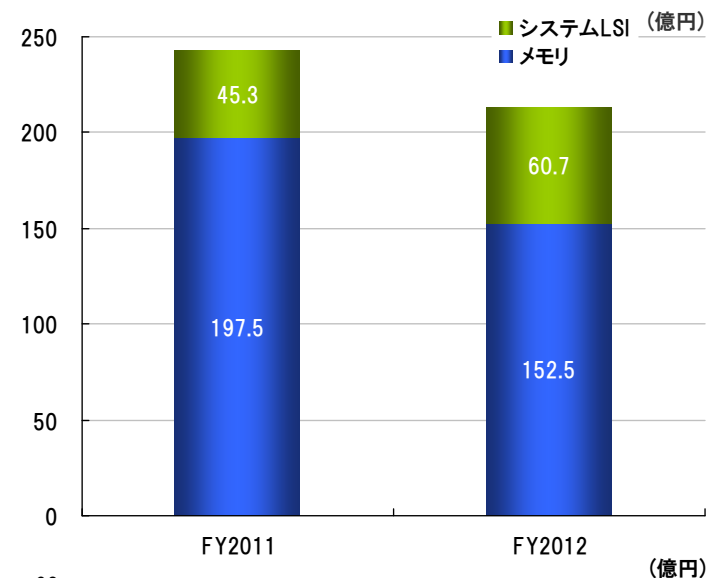
4Q実績(QoQ)

<メモリ事業>

- ・モバイル向け製品は受託数量が増加するが、PC向け製品は受託数量が更に減少

<システムLSI事業>

- ・テスト受託は横ばいで推移したものの、WLPの受託減により売上高が減少



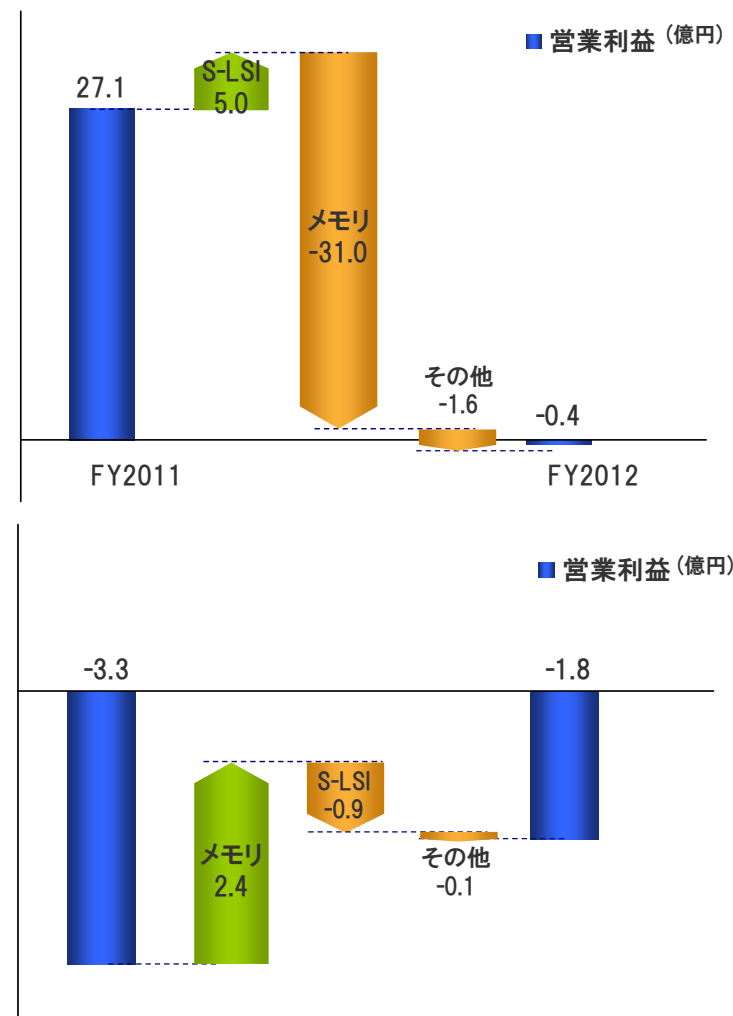
2012年度実績増減分析(営業利益)

2012年度実績(YoY)

- ・メモリ事業は経費削減を進めるが、PC向け製品の受託減少で売上高大幅減のため、利益大幅減
- ・システムLSI事業はWLP受託が低調に推移するも、テスト受託では黒字を確保し、収益改善

4Q実績(QoQ)

- ・メモリ事業はPC向け減少するも、モバイル向け製品の受託増により収益改善
- ・システムLSI事業はテスト受託、WLPとも受託微減によりやや収益悪化



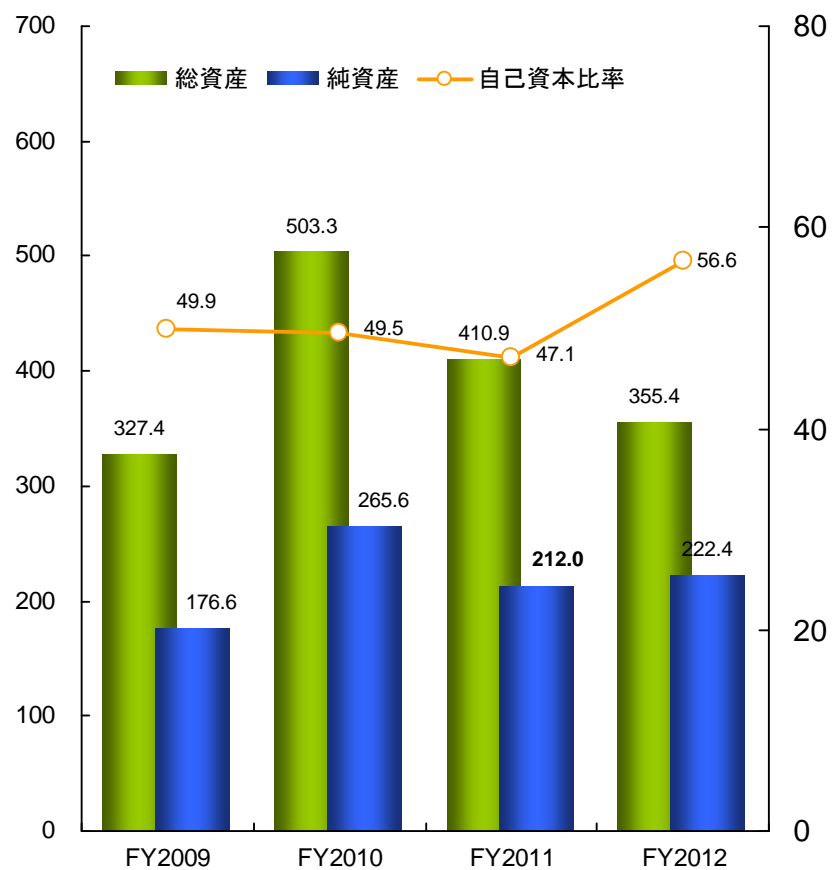
貸借対照表の比較

(億円)

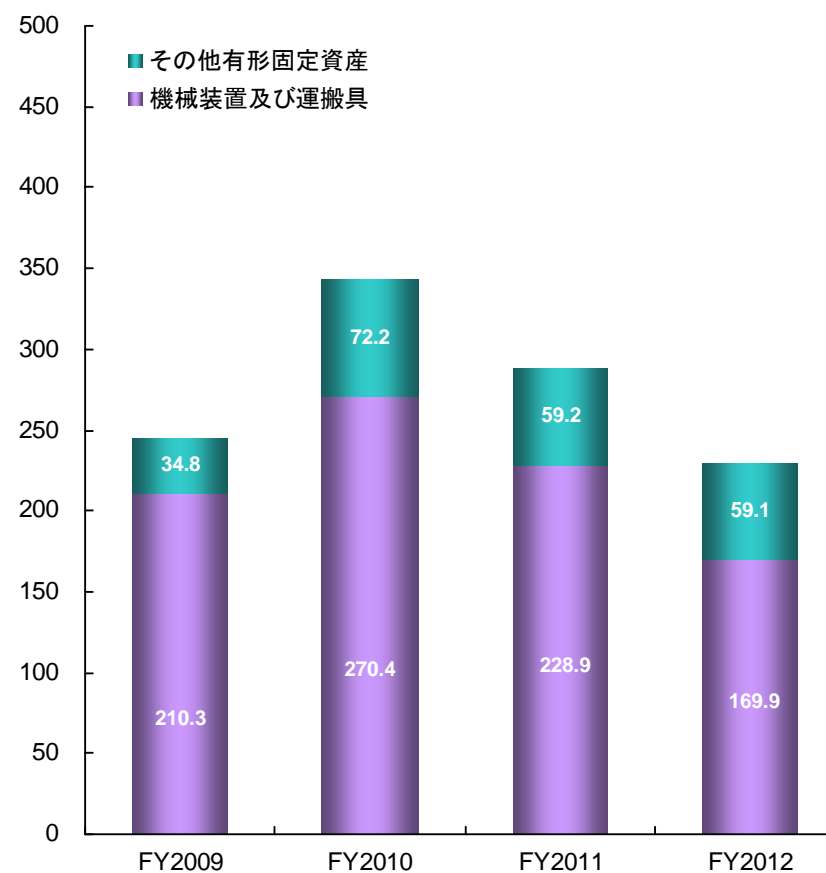
	2012/3	2013/3	差異
流動資産	106.7	110.2	3.5
現金及び預金	55.5	62.4	6.9
売掛金	35.3	36.3	1.0
固定資産	304.1	245.1	-59.0
機械装置	228.8	169.8	-59.0
資産合計	410.8	355.4	-55.4
流動負債	112.9	77.6	-35.3
借入金	21.5	17.6	-3.9
リース債務	39.6	27.2	-12.4
固定負債	85.9	55.4	-30.5
長期リース債務	72.6	45.2	-27.4
純資産	211.9	222.3	10.4
負債純資産合計	410.8	355.4	-55.4
自己資本比率	47.1%	56.6%	9.5%

財務状況の推移①

総資産・純資産・自己資本比率



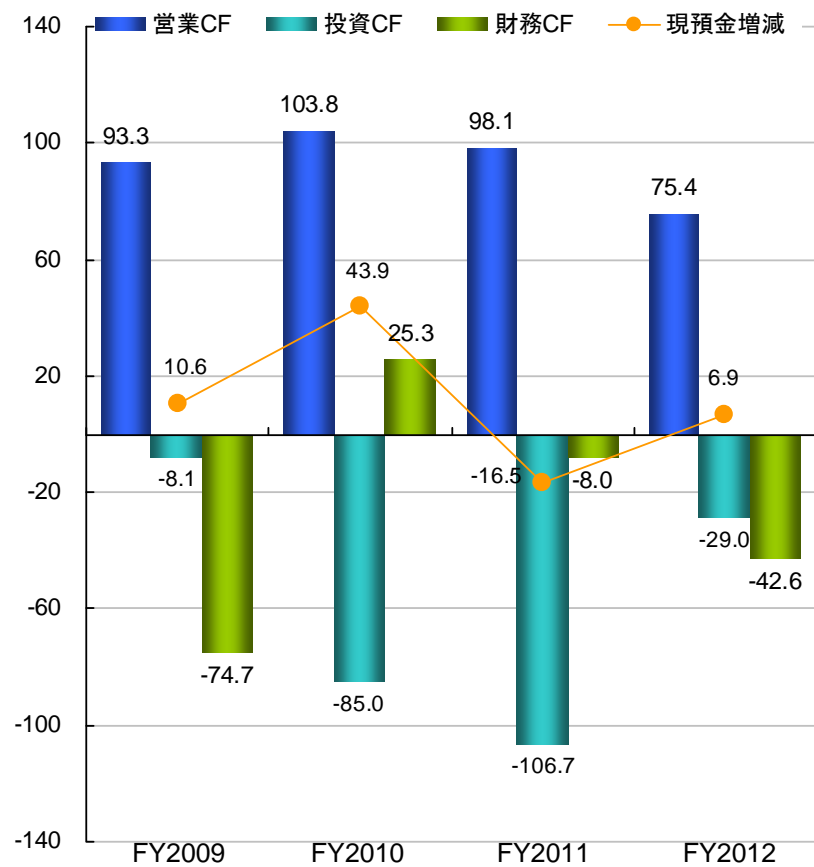
有形固定資産の推移



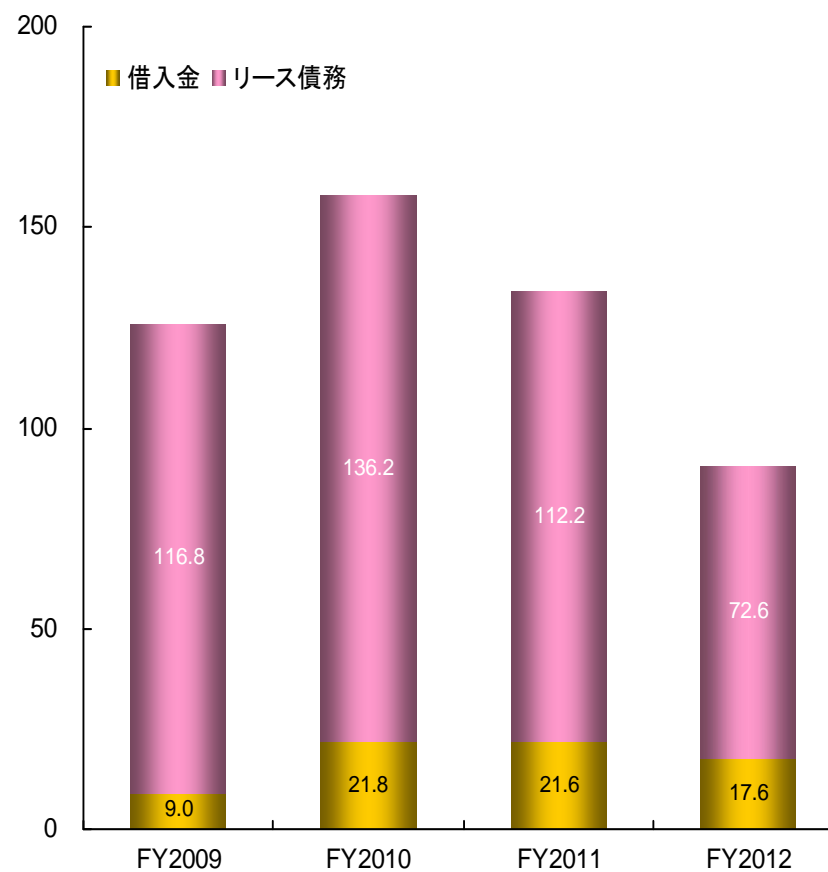
単位:億円

財務状況の推移②

キャッシュフロー



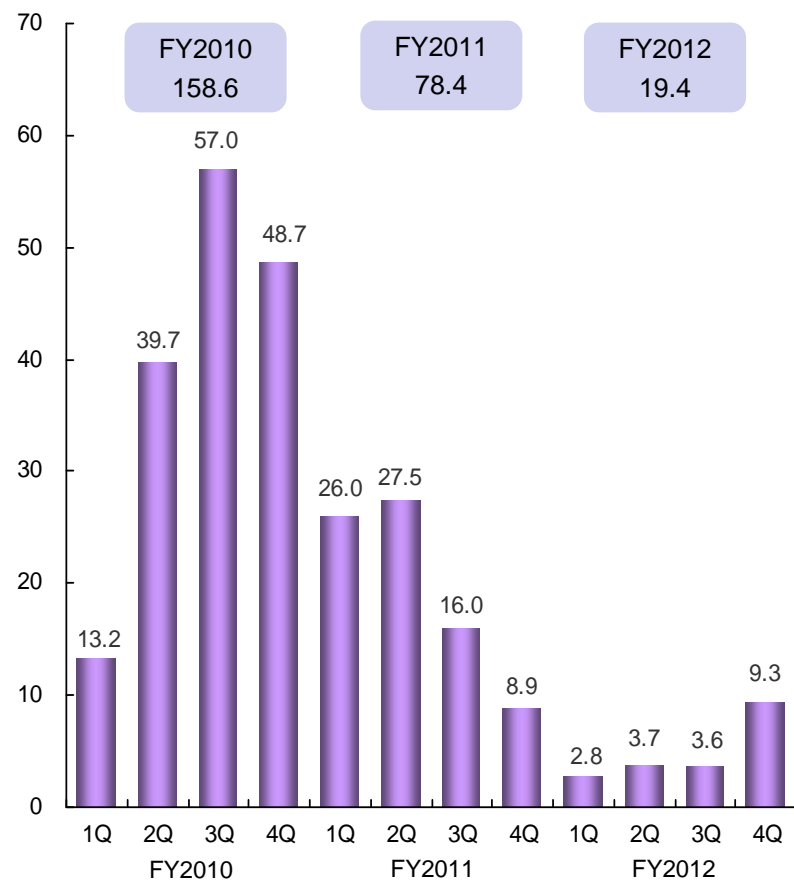
借入金・リース債務残高



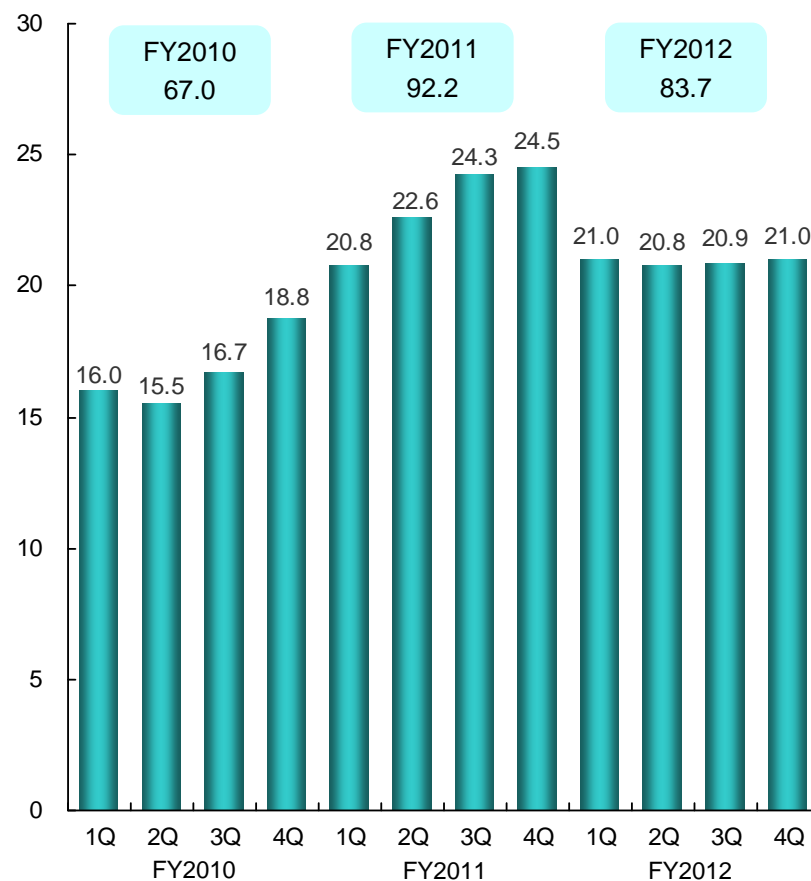
単位:億円

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移



単位: 億円

2012年度のトピックス

メモリ事業

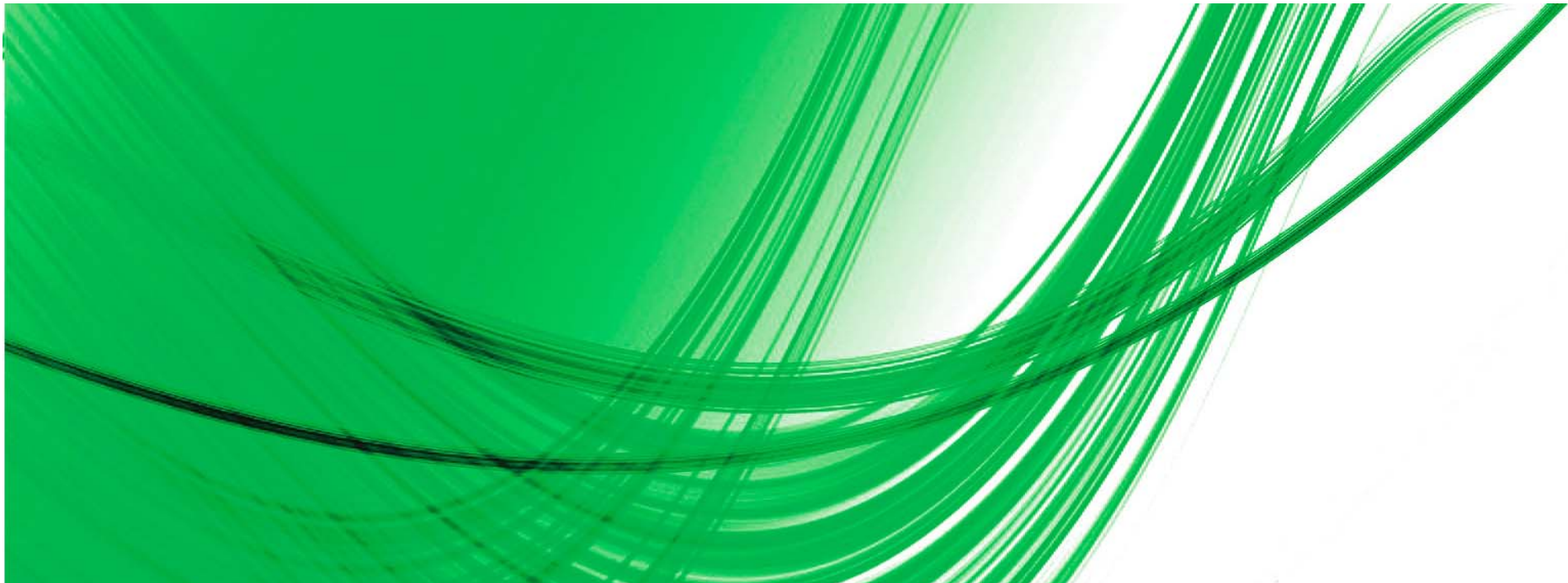
- ファイナルテストを開始
- ウエハ状態での高速テスト技術の開発
- 次世代メモリ製品のテスト技術の開発

システムLSI事業

- LEDのテスト受託開始
- TeraPowerにおいてISO/TS16949(自動車産業向け品質マネジメントシステム)認証取得
- タイヘイ電子の半導体事業の一部を譲り受け
- 新日鉄住金マテリアルズへの委託業務を内製化



2014年3月期第1四半期業績予想



第1四半期業績予想の概要

メモリ事業

- モバイル用DRAMの受託数量は前4Q比増加
但し、製品ミックスの変化により、テストの稼働率は横ばい

システムLSI事業

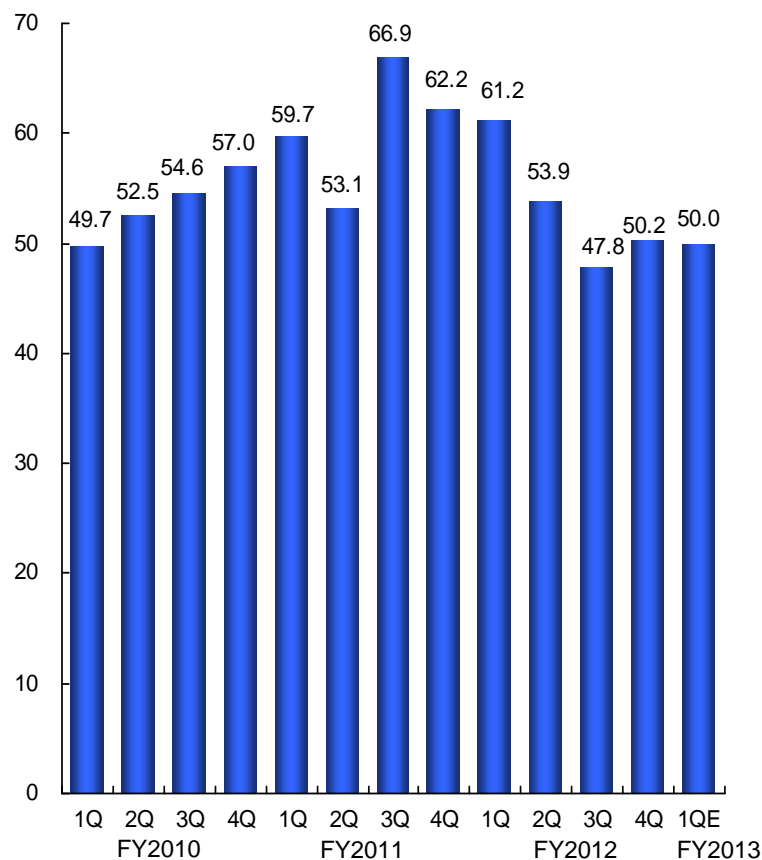
- テストの受託量は前4Q比横ばい
- WLPの受託量は前4Q比緩やかに増加



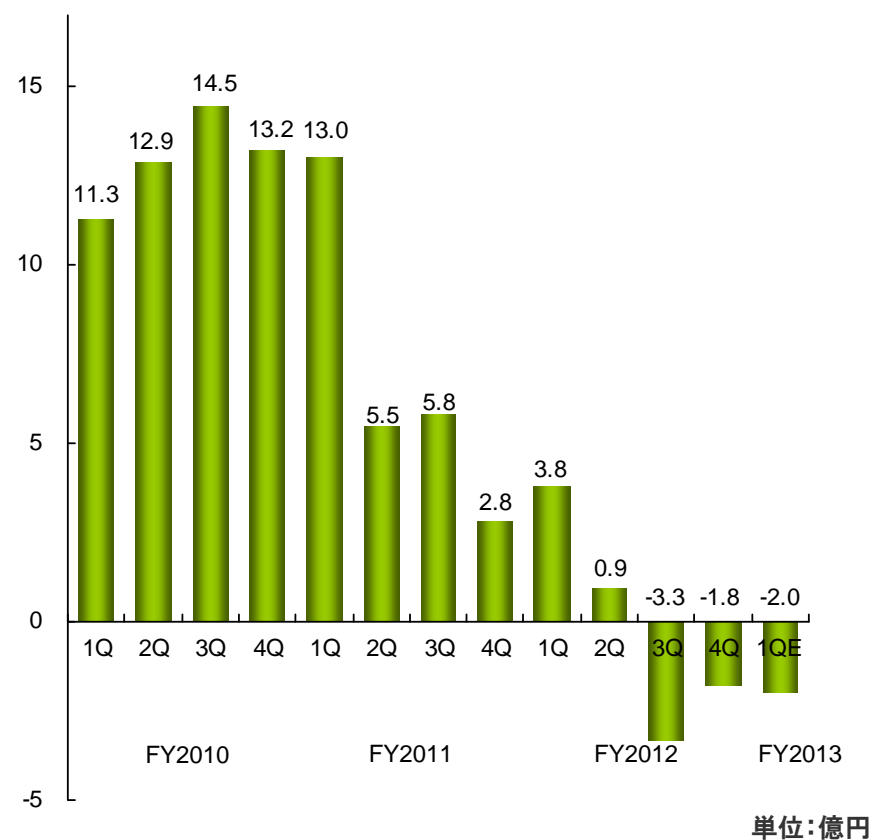
前四半期(FY2012/4Q)から売上、利益とも横ばい

売上高及び営業利益推移

売上高推移



営業利益推移



当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成25年3月期決算短信」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門
TEL (045)476-5711
URL <http://www.teraprobe.com>

このページは表示しない

Memo (業績予想)

償却費は下期に前年比9億程度減少(収益改善)

エルピーダ受託推移

ウエハ受託数量	モバイル受託数量
FY2011 1,384.8K	FY2011 459.2K
FY2012 1,124.1K	FY2012 736.1K
FY2013(e) 1,200K?	FY2013(e) 1,000K?

モバイルの受託増あるが、PC減により、
ウエハ総数はFY2011まで回復せず
更に、微細化あるも2Gb→4Gbにより、
チップ数減少

	1Q/2011	2Q/2011	3Q/2011	4Q/2011	FY2011	1Q/2012	2Q/2012	3Q/2012	4Q/2012	FY2012	1Q/2013	FY2013e
Mobile	197.4	95.7	56.5	109.6	459.2	142.1	190.6	171.5	231.9	736.1	250	1000
PC	156.7	242.8	306.2	219.9	925.6	170.3	97.6	68.1	52	388	50	200
Wafers	354.1	338.5	362.7	329.5	1384.8	312.4	288.2	239.6	283.9	1124.1	300	1200
T.T.	85.6	82.5	81.3	89.3	338.7	78.1	75.8	75.8	75.2	304.9	75	300
負荷	30311	27926.3	29487.5	29424.4	117149	24398.4	21845.6	18161.7	21349.3	85755	22500	90000

このページは表示しない

想定質問

質問	回答
上場時にDRAMの売上を減らさずに、センサ、アナログ、ターンキーで成長を目指すと言っていたが、13年度以降も同じ方針か？	基本的に方針は変わっていない。 特に車載用途の製品の取り込みを強化していきたい。
上場時に3年後(FY13)にエルピーダ比率50%、売上330億円と言っていたが、どうなのか？	市場環境が変わってきており、売上高についてはもう少し低くなりそうだが、エルピーダ比率については、達成できるよう頑張っていきたい。
中国、韓国でのオンショアビジネスを12年度に開始としていたがどうなっているのか？	中国、韓国でのビジネス展開は現在も模索中だが、単独での進出は難しいため、最適なパートナーを選定している。